

# 真空リフロー炉 SVR-625GTC

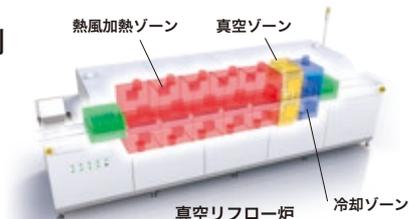
Vacuum Reflow Oven SVR-625GTC

## はんだ付けを熟知しているメーカーの、真空リフロー装置

Vacuum Reflow Oven based on Experienced Soldering Technologies

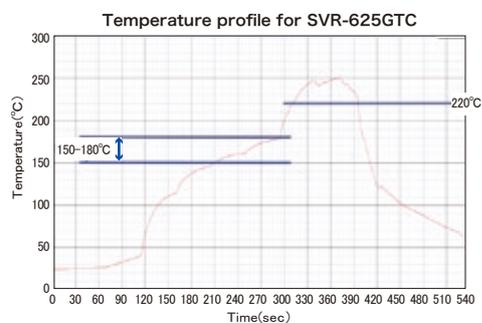
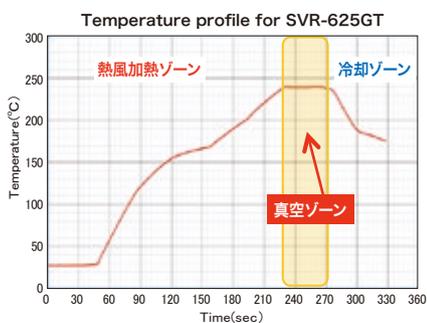
### 特長

- はんだが溶融するピーク温度領域で減圧させ、ポイド低減と飛散を抑制
- 4段階の減圧パターンを有し、最適な条件で部品ズレやポイドを低減
- 温度調節可能な真空ゾーンが、飛散やポイドを低減

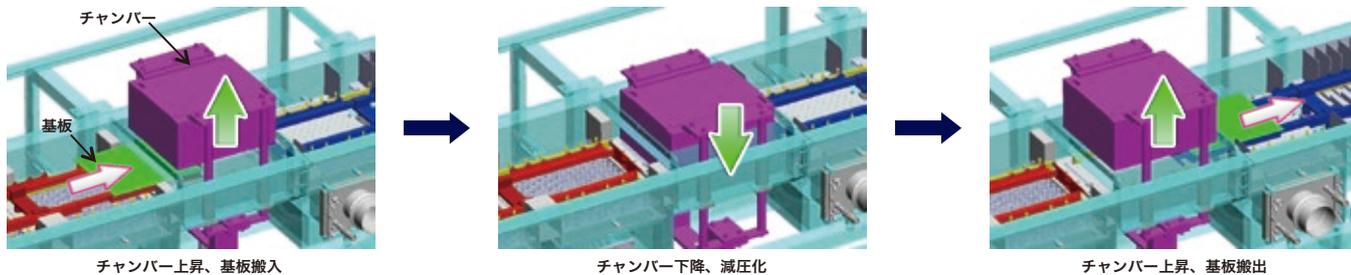


### 仕様

- はんだが溶融している最適な状態で真空度と真空時間を制御し、ポイドの低減とはんだの飛散を抑制



- 昇降式真空チャンバーが減圧度合を再現し、ポイドと飛散のバラツキを抑制



- 各種部品でのポイド低減の評価結果

	QFN 8mm	Pw Tr	LGA 19mm	BGA 19mm
汎用炉 (Air)				
真空炉 (N <sub>2</sub> ) SVR-625GTC				